

期刊	高层观点	封面故事	趋势洞察	元件与模组	分销与供应链	制造与工艺	特刊
1月刊 广告预订截止日期: 2024年11月22日 材料提交截止日期: 2024年11月28日	•	电子行业十大趋势	智能汽车	/	全球供应链现状	-	-
2月刊 广告预订截止日期: 2024年12月23日 材料提交截止日期: 2024年12月30日	•	出海商机	绿色节能	存储主控	数字化供应链	晶圆制造	-
3月刊 广告预订截止日期: 2025年1月20日 材料提交截止日期: 2025年1月22日	•	国际电子商情 创刊40周年特别主题	全球/本土电子行业 40周年回顾	/	全球/本土分销行业 40周年回顾	-	-
4月刊 广告预订截止日期: 2025年2月20日 材料提交截止日期: 2025年2月28日	•	大数据存储	边缘计算	电源模块	供应链管理	新材料应用	-
5月刊 广告预订截止日期: 2025年3月20日 材料提交截止日期: 2025年3月28日	•	人工智能	智能手机	电容/电感/电阻	智能仓储	-	-
6月刊 广告预订截止日期: 2025年4月21日 材料提交截止日期: 2025年4月28日	•	2024年全球/中国分销商排名	智能制造	功率器件	小批量分销	PCB制造	-
7月刊 广告预订截止日期: 2025年5月20日 材料提交截止日期: 2025年5月28日	•	低空经济	自动驾驶	无线模块	技术分销	-	-
8月刊 广告预订截止日期: 2025年6月20日 材料提交截止日期: 2025年6月27日	•	工业机器人	四足机器人	MEMS传感器	国产供应链	半导体设备	-
9月刊 广告预订截止日期: 2025年7月21日 材料提交截止日期: 2025年7月28日	•	智能家居	汽车MCU	微型电机	库存管理	-	-
10月刊 广告预订截止日期: 2025年8月20日 材料提交截止日期: 2025年8月28日	•	5G/6G	无线通信	射频前端	元器件电商	自动化测试	-
11月刊 广告预订截止日期: 2025年9月19日 材料提交截止日期: 2025年9月26日	•	汽车电子	智能穿戴	晶振	分销金融服务	-	-
12月刊 广告预订截止日期: 2025年10月20日 材料提交截止日期: 2025年10月28日	•	先进封装	Chiplet	无线充电	可持续供应链	半导体封装	分销与供应链专刊

有关编辑查询和其他相关事项:

请与 Clover Lee (clover.lee@aspencore.com) 联系。

注: 封面故事、元件与模组、分销与供应链所列主题需采访企业; 编辑观点、趋势洞察、制造与工艺所列主题以深度原创为主; 发行人保留对以上文章删除及改动的权利。